

經濟部新聞稿

鞏固全球半導體產業韌性—臺灣競爭優勢與策略

行政院長蘇貞昌今（18）日在行政院會聽取經濟部「鞏固全球半導體產業韌性—臺灣競爭優勢與策略」報告。經濟部表示，半導體產業是臺灣核心關鍵產業，而臺灣過去在半導體專業分工下塑造的上中下游完整產業聚落以及領先全球的先進製程技術，造就臺灣在全球半導體產業競爭中保持領先優勢，持續吸引國際大廠來臺投資。

經濟部指出，在疫情與地緣政治衝擊下，全球各國已經體認到半導體的戰略重要性，也紛紛推動政策支持本土半導體產業之發展。臺灣在半導體專業分工下各次產業蓬勃發展，2021年晶圓代工與IC封測產業市占全球第一，IC設計產業市占全球第二，而臺灣所生產之晶片銷售全球，在全球占有重要地位。

政府相當重視半導體產業的發展，也積極推動臺灣成為全球半導體製造的重鎮，除支持臺灣主要晶圓大廠繼續在臺擴產建廠外，也透過推動半導體材料設備在臺發展，致力於吸引國際大廠來臺投資，進一步完備臺灣半導體產業生態體系。近年來，臺灣半導體產業相關投資案穩定增加，投資金額大幅增長，成果斐然。

台積電、力積電、南亞科技，以及美國記憶體大廠美光（Micron Technology）的投資有助於強化臺灣北部已經成形的半導體產業聚落。另一方面，台積電與德國半導體材料大廠默克（Merck）等在南部科學園區的投資，結合相關材料設備廠的投入，對於南部半導體產業聚落的發展至為重要。

面對國際激烈的半導體產業競爭，以及各國積極推動政策爭取半導體業者設廠發展，臺灣將持續憑藉完整的產業聚落、領先的製程技術，以及高度支持的政策環境，持續推動國內外投資，維繫臺灣半導體產業在全球之競爭力。